



CIOE 信息通信展是亚太地区极具影响力的信息通信技术专业展览会,集中展示芯片、材料、器件、模块、设备、方案等全产业链板块的新产品、新技术、新趋势及新应用,促进设备商、工程商、运营商、互联网等企业与上下游供应商进行商贸沟通,达成商业合作,获悉前沿应用、洞察新兴趋势。

AOI、ARTILUX、ALIGHT、BROADCOM、COHERENT 高意、COLORCHIP、CREDO、DENSELIGHT、HAMAMATSU、HITACHI、INSIGA、IRIDIAN、MACOM、MARVELL、PIC ECOSYSTEM、PPI、POET、REALBROAD、SICOYA、SEMTECH、SIFOTONICS、光迅、烽火、海思、海信、贝思科尔、斑岩光子、曦智、源杰、芯思杰、敏芯、奇芯、国家信息光子创新中心、长光华芯、河南仕佳、明夷科技、剑桥、烽火、科大亨芯、云岭光电、光森、橙科微、慧芯、功芯、鼎芯、三安集成、中电十三所、度亘、工研拓芯、新微半导体、鹏瞰科技、光安伦、厦门优迅、中科光芯、神州高芯、领慧立芯、联合微电子、亿芯源、仟目激光、嘉纳海威、苏纳光电、华芯半导体、艾锐光电、元芯、全磊光电、电科芯片、常州光芯、飞昂、长瑞光电、微龛、芯耘、贝思科尔、欧亿、觉芯电子、傲科、矽安光电、国惠光电、博升、富泰科技、光隆科技、逍遥科技、洪芯、宏芯科技、凌越、光特、矽感锐芯、睿熙、中科院微电子研究所、中科微光子、卓昱光子、米硅、摩本、科谱、胜创、芯波微、赛格瑞、纳米克、华飞、双芯微、勒威、汉希科特、老鹰半导体、微视传感、众瑞速联、宙镓、易缆微、固家、安湃芯研等企业(排名不分先后)都将带来部分光芯片、电芯片的产品的精彩展出。

日立高新技术(深圳)贸易有限公司 HITACHI

展位号: 11D52

所属展区: 信息通信展



公司简介:

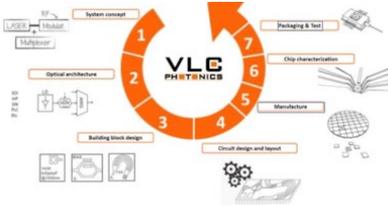
日立高新技术在光通讯领域持续为客户提供相关代理材料销售工作,并根据客户需求定制代工服务。超过 25 年以上的充足光通讯市场经验,在贩卖产品的同时也为客户整合资源并提供光通讯半导体相关生产和测试设备的贩卖和一站式工业互联网智能工厂解决方案。



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

光子集成电路芯片



产品介绍:

我们的光电子芯片设计厂商来自西班牙的 VLC 公司，提供将传统光电封装工艺的光电元件集成为一体的光电子集成芯片设计，测试及制造服务。

成都英思嘉半导体技术有限公司 INSIGA

展位号： 12A61

所属展区： 信息通信展



公司简介:

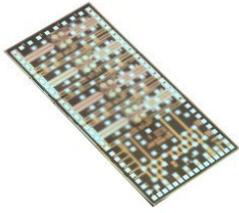
成都英思嘉半导体技术有限公司成立于 2016 年,专注于 10G~800G 速率光通信 Driver, CDR, TIA 和 OSA 产品的研发与生产。目前英思嘉半导体已经开发出一系列几十种 10G/25G/50G/100G/200G/400G/800G 高速光通信芯片及光组件产品,积累了多项相关专利技术。基于英思嘉半导体芯片方案的 5G 中传/回传产品,200G、400G 数据中心产品已经处于大批量生产和交付阶段。以满足客户需求为使命,英思嘉半导体将持续创新,开发更多的高速 IC 和 OSA 产品,为客户提供一流的产品、技术以及相关服务,助推 5G 和数据中心光传输市场的高速发展。

ISG-D5640H 53Gbaud/s 四通道 MZ 驱动器



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

**产品介绍:**

英思嘉 ISG-D5640H 是一款适用于 LPO, 400G DR4, 800G DR8 应用的高性能、四通道 53Gbaud/s MZ 驱动芯片。该驱动器差分输入高达 500mVpp, 增益高达 26dB。在线性模式下, 输出摆幅高达 3.5Vpp。集成 SPI 控制器功能; AGC 自动增益控制功能; 提供共模电压监测功能; 提供了 PIC 加热器控制和两路自动光功率控制功能。

ISG-C2925 25G CDR+EML+BM LA**产品介绍:**

英思嘉 ISG-C2925 是业界首款 25G CDR + EML Dr. + BM LA Combo Chip 产品, 旨在满足新一代 25G PON OLT 的应用需求, 适用于 25G 对称和 50G 非对称应用。该产品发端配有 CDR 和 EML 驱动器, 收端配有支持突发模式的 25Gbs 限幅放大器。发端实现了输入均衡可调、LOS 功能和 EML 驱动器眼图调节功能。收端的突发模式限幅放大器具有 EQ 可调和去预加重功能, 同时提供高速 SD/LOS 功能且检测阈值可调。封装规格为 4.5x4.5mm, 小巧紧凑便于设计应用。

光电集成生态系统 PIC ECOSYSTEM

展位号: 12D11

所属展区: 信息通信展

PIC
ECOSYSTEM



扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

公司简介：

PIC ECOSYSTEM（光电集成生态系统）基于集成光电子多材料体系，实现从 EPDA 工具、PDK 开发、流片、封装测试到应用的垂直整合。PIC ECOSYSTEM 协同全球光电集成上下游伙伴，定期组织“光电集成生态系统”工业论坛，并于每年 09 月（CIOE 同期）和 11 月（OVC 同期）进行“光电集成生态系统”展会展示。

光电集成芯片设计和制造



产品介绍：

电磁场仿真工具,链路仿真工具,芯片版图工具,芯片设计和版图服务,SOI 硅基光电子芯片流片服务,Si3N4 光电集成芯, 流片服务,LNOI 光电集成芯片流片服务,III-V 光电集成芯片流片服务,SiO2 光电集成芯片流片服务。

光电集成芯片封装和系统



产品介绍：

高精度芯片贴装,高精度微透镜耦合,高精度 FA 和透镜光纤耦合,激光器老化,硅光模组老化,双光子三维灰度光刻,硅光通信光模块封装,硅光计算模组封装,集成激光雷达模组封装,集成光学频率梳模组封装,集成光子量子信息模组封装,超分辨成像,和生物学光电模组封装。

PPI

展位号： 12A808

所属展区： 信息通信展

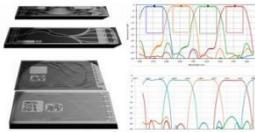


扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

股份公司 PPI，基于 PLC (Planar Lightwave Circuit) 平面光波导的基础技术。 我公司提供主要产品 AWG (I-temp, High-Power 高功率) &TFF 模块、CWDM、WDM、光功率计、用于 FTTH 的 PLC 分路器、光传感器&传感系统、PON-功率计、光监控系统等，以满足客户的所有要求。 通过我们公司特有的 PLC (Planar Lightwave Circuit) 和 AWG 技术，使我们能够为长距离传输，前端传输和城域网建设生产关键器件

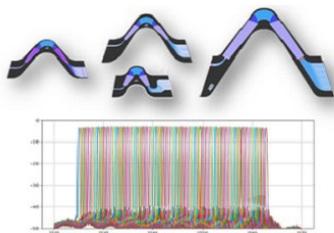
MUX/DEMUX 芯片



产品介绍:

MUX-芯片 DEMUX-芯片 LWDM-芯片 CWDM4-芯片

AWG 芯片



产品介绍:

32CH-AWG 芯片 40CH-AWG 芯片 48CH-AWG 芯片 80CH-AWG 芯片 96CH-AWG 芯片

WDM 芯片

Over 20 years challenge PLC technology

- 40G / 100G / 200G / 400G Solution for CWDM4, FR4, LR4, LR8
- Applicable to QSFP-DD, QSFP+, CFP, CFP2, CFP4
- Custom design / size & Foundry service available

产品介绍:



扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

CWDM CHIP DWDM CHIP LWDM CHIP

波亿光电子深圳有限公司 POET

展位号： 11C63

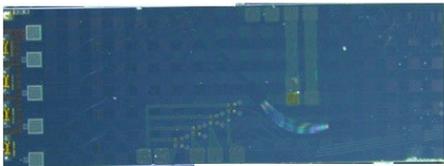
所属展区： 信息通信展



公司简介：

POET Technologies Inc 作为全球光电子集成芯片领导者，基于自主研发的 optical interposer 技术平台，致力于为市场提供领先的光电子集成芯片产品及解决方案。POET 持续在晶圆级别的光电子混合集成的投入和研究，打造全球领先的晶圆级别集成平台，实现低成本，高性能，高集成度的光电子芯片，为客户提供真正的竞争优势和卓越价值，推动社会信息技术的发展。POET 目前已经完成应用于包括 100G、200G、400G、800G 及 1.6T 场景的光电子集成芯片研发。

400G Transmitter OE



产品介绍：

400G FR4 光引擎系列产品是基于 POET Optical Interposer， 100G DFB 激光器，专有的 Flip-chip 工艺，为终端客户提供高性能和低成本 400G 芯片方案。

800G Receiver OE



扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)



产品介绍:

POET 800G (2x400G FR4) 接收机光引擎集成 SSC, 偏振不敏感低损耗 Demux, 56G PD 及 800G TIA 于一体。为业界最小 800G 接收机光引擎。

深圳市贝思科尔软件技术有限公司

展位号: 11D021

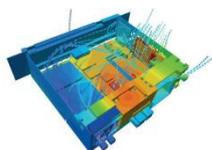
所属展区: 信息通信展



公司简介:

深圳市贝思科尔软件技术有限公司成立于 2011 年, 专注于为国内高科技电子、半导体、通信等行业提供先进的电子设计自动化 (EDA)、工程仿真分析 (CAE)、半导体器件热阻 (Rth) 及功率循环 (Power Cycling) 热可靠性测试, 以及研发数据信息化管理的解决方案和产品服务。贝思科尔与国际上领先的专业软件厂商有着广泛的合作, 乐于将国外优秀的设计工具、仪器设备、管理平台乃至前沿的开发理念引入中国市场, 帮助本土的电子研发企业提升设计效率和产品可靠性。我们的合作伙伴包括: Siemens EDA (原 Mentor)、Siemens Simcenter (西门子, CAE)、ATS (热测试设备) 等。

FloTHERM/FloEFD 热仿真软件





扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

产品介绍:

FloTHERM: 专业电子热设计/热仿真分析软件 -支持多 CPU 无限并行运算/求解速度业内最快 -芯片级/板级/系统级/环境级热分析 -80%电子散热市场占有率 -支持目标驱动自动优化设计 -参数化建模功能/智能模型库 -基于互联网的标准 IC 封装热分析模型库 FloEFD: 主流三维 CAD 软件中的高度工程化的通用流体传热分析软件 -直接嵌入三维 CAD 软件环境 -矩形的自适应网格 -修正的壁面函数 -强大的层流-过渡-湍流模拟能力 -自动收敛控制和变量设计分析 -工程化的用户界面

深圳市斑岩光子技术有限公司

展位号: 12E21

所属展区: 信息通信展



公司简介:

斑岩光子成立于 2020 年 5 月, 拥有世界一流的光子集成设计团队, 核心团队从事光子集成芯片开发多年, 实现了基于 InP 光子集成平台的高速 EML 激光器、相干光子芯片等产品的设计与制造。斑岩光子是国内首家提供 200G PAM4 EML 方案的企业, 实现国产化零的突破。

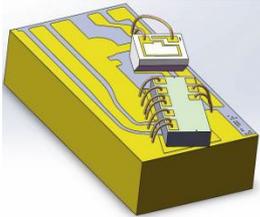
斑岩采用 4 inch 晶圆以及单次外延工艺, 可以低成本、高可靠性的实现光芯片量产。斑岩对 EML 设计也有独特的理解, 除了传统的单端驱动 EML, 还创新性的开发了支持调制信号差分驱动 EML。该差分 EML 芯片在短距数通应用中, 可省去外置或者 CDR/DSP 集成的驱动芯片, 有效降低成本及功耗; 在长距传输应用则可使用差分驱动器实现高消光比/高带宽。



扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

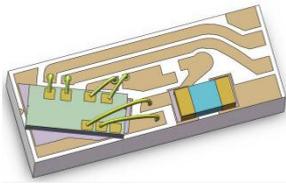
28GBaud/56GBaud/112GBaud EML



产品介绍:

高速 EML 芯片, 速率 28GBaud/56GBaud/112GBaud, 支持 100G-ER4/ZR4, 100G-LR1/ER1, 400G-DR4/FR4/LR4/ER4, 800G-FR4/LR4 等应用。

28GBaud/56GBaud 差分驱动 EML



产品介绍:

高速差分驱动 EML, 速率 28GBaud/56GBaud, 可以由不集成 Driver 的 CDR 或者 DSP 直接驱动工作, 支持 100G-LR4/200G-FR4, 400G-DR4/FR4 等应用。

上海曦智科技有限公司

展位号: 11D091

所属展区: 信息通信展



公司简介:

曦智科技(Lightelligence)成立于 2017 年, 是全球光电混合计算领军企业。公司凭借在集成光子领域的开创性技术和全球顶尖的集成电路技术研发团队, 致力于在计算需求爆发的时代, 为客户提供一系列算力跃迁解决方案, 与客户共建更智能、更可持续的世界。曦智



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

科技以光子矩阵计算(oMAC)、片上光网络(oNOC)和片间光网络(oNET)三大核心技术出发,打造光子计算和光子网络两大产品线,与大数据、云计算、金融、自动驾驶、生物医药、材料研究等领域客户开展紧密合作,持续为客户提供更具创造性的高效算力支撑。

Moonstone



产品介绍:

Moonstone™是一款集成激光光源产品,它具有小型化、高功率、单/多波长等特点,可支持曦智科技所有产品系列,亦可为第三方应用提供激光光源解决方案。Moonstone™组件为客户提供了一种具有竞争力的激光光源解决方案,可实现多至8个通道波长的光输出,除了良好的内部光耦合效率和控温设计,该产品同时具备了高功率和低功耗的性能优点。

PACE



产品介绍:

PACE是曦智科技第二代光子计算处理器。PACE的核心是64x64的光学矩阵乘法器,由一块集成硅光芯片和一块CMOS微电子芯片以3D封装形式堆叠而成。PACE的单个光子芯片中集成超过10000个光子器件,运行1GHz系统时钟,运行特定神经网络算法的速度可达目前高端GPU的数百倍。

陕西源杰半导体科技股份有限公司

展位号: 12B51

所属展区: 信息通信展



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



公司简介：

陕西源杰半导体科技股份有限公司（简称：源杰科技）成立于 2013 年 1 月 28 日，专注于进行高速的半导体芯片的研发、设计和生产，是一家从半导体晶体生长，晶圆工艺，芯片测试与封装全部开发完毕，并形成工业化规模生产的高科技企业。产品涵盖从 2.5G 到 50G 磷化铟激光器芯片，拥有完整独立的自主知识产权，从最终的使用场景来看，产品广泛应用于光纤到户、数据中心与云计算、5G 移动通信网络、通信骨干网络和工业物联网等。经过多年的稳健发展，公司产品的技术先进性、市场覆盖率和性能稳定性位居行业前列。

10G&25G CWDM6 DFB Laser



产品介绍：

应用于 5G 前传，面对 5G 前传高速率、大容量、省光纤的应用场景，该系列芯片源杰 2020 年国内发货量位居榜首，大批量交付给多个业内领先的光模块和系统设备厂家。

芯思杰技术（深圳）股份有限公司

展位号： 11A53

所属展区： 信息通信展



公司简介：

芯思杰技术（深圳）股份有限公司成立于 2015 年，系 IDM 型第二代半导体企业，公司立足国家电子信息产业战略前沿的光电子器件行业，致力于成为全球光电子技术领域的领军企业。公司主营产品为光电探测器芯片，主要应用于光通信和光传感场景。凭借多年深耕光



扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

电探测器芯片研发设计及生产工艺，结合产业化经验和技術积累，公司可独立自主进行光电探测器芯片的研发设计、生产流片、检测封装等工艺环节，为客户提供全方位、一体化、快速响应的专业服务和高性能、高可靠、高精度、高速率的光电探测器芯片产品。

多通道 56GBaud InGaAs PIN PD 系列芯片



产品介绍：

该多通道 56GBaud 阵列 400Gbps 光探测器芯片，是顶部入光和台面结构的高速数字 PIN 光探测器芯片，该系列产品对应的光敏区直径分别有 16 μ m、20 μ m、22 μ m、24 μ m。芯片间距有 500 μ m 和 750 μ m 两种。产品主要特点是高带宽、低电容、低暗电流和高可靠性，该产品广泛应用于 400G 和 800G 数据中心。

25Gbps/50Gbps APD 芯片



产品介绍：

该 25Gbps/50Gbps APD 光探测器芯片是 GSG 电极结构，为正面入光的高速雪崩光探测器芯片，光敏区尺寸分别是 Φ 16 μ m/ Φ 12 μ m。产品的主要特点是高倍增、低电容、低温度系数和高可靠性，主要用于 25G PON、50G PON、5G 无线和 100G ER4。

武汉云岭光电股份有限公司

展位号： 12T32



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

所属展区： 信息通信展



公司简介：

武汉云岭光电从光通信产业链顶层核心光芯片和器件出发，专注于光通信用激光器和探测器芯片及器件产品研发、制造及销售，是光通信行业内具备垂直产业链（IDM）与生产研发能力的光芯片企业。公司以 2.5G/10G/25G/50G 全系列激光器和探测器芯片及封装类产品为主营业务，建立了省级企业技术中心等技术研发平台，自主掌握芯片设计、材料生长、工艺、封装、测试等核心技术，自主掌握中高端光收发芯片的核心研发技术，并具备批量生产的能力。先后获评工业和信息化部第四批专精特新“小巨人”企业、湖北第三批省专精特新“小巨人”企业、湖北省高新技术企业、湖北省科创“新物种”潜在独角兽企业等多项荣誉。

EML 25G 1310/1358nm/LWDM chip



产品介绍：

EML 25G 1358nm Chip，在 20°C~60°C 工作温度下运行速率高达 28G，脊波导结构，具有多量子阱 n 型衬底有源层和光栅，低阈值电流，用于以太网、数据中心等。28G LWDM Chip，波长覆盖 1295.56/1300.05/ 1304.58/ 1309.14 nm，在 LWDM 最高运行速率可达 28G，脊波导结构，具有多量子阱 n 型衬底有源层和光栅，低阈值电流，工作温度范围为 20°C 至 60°C，符合 RoHS 标准，符合 Telcordia GR-468 标准，用于光纤以太网等。

EML 10G1550nm/1577nm/DWDM chip



产品介绍：

EML 10G 1577nm Chip，脊波导结构，具有多量子阱有源层和单片集成量子阱 EA 调制器，



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

冷却操作温度为 45°C至 55°C，主要用于 XGSPON OLT；EML 10G TDM/DWDM Chip，波长覆盖 1529.55nm 到 1560.61nm，ITU DWDM 100GHz 信道间距，脊波导结构，高可靠性激光器和 EA 调制器设计，传输距离可达 80Km，冷却操作温度为 45°C至 55°C，符合 RoHS 标准，符合 Telcordia GR-468 标准，用于光纤以太网等。

EML 56G1310nm/1342nm/CWDM chip



产品介绍：

EML 56G 1342nm Chip，脊波导结构，具有多量子阱（MQW）有源层，单片集成量子阱 EA 调制器，冷却操作温度为 45°C至 55°C，符合 RoHS 标准，符合 Telcordia GR-468 标准，应用于 50G PON。EML 56G 1271/1291/1311/1331nm，脊波导结构，DFB 激光器集成高速电吸收调制，使用 56GBd PAM4 信号支持 112Gb/s，低阈值电流，工作温度 50°C，符合 RoHS 标准，符合 Telcordia GR-468 标准。

功芯科技（广州）有限公司

展位号： 12A91

所属展区： 信息通信展



公司简介：

功芯科技专注于国际领先的高速光电芯片研发与销售，立志为客户提供行业领先的光电接口芯片及解决方案，其产品广泛应用于数据中心、相干光通信、 5G、光纤到户、消费电子和自动驾驶等领域。公司成立于 2020 年，在广州、上海、苏州和新加坡设有研发或运营中心。

Coherent Driver and TIA





扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

产品介绍:

相干光通信用 driver 和 TIA 芯片组, 传输速率覆盖 64G~128GBaud。芯片具有带宽高, 功耗低, 增益大, 支持倒装焊封装, 具有 SPI 和模拟两种控制接口等特点。driver 芯片差分输出幅度高达 4Vpp, 可调增益范围大, 内置 peaking detector。TIA 芯片输入噪声电流低, AGC 输出幅度可调, 具有 AGC 和 MCG 模式。

Nx100G PAM4 driver and TIA



产品介绍:

芯片支持单通道/4 通道/8 通道, 发射端有支持 VCSEL 和 MZI 不同的 driver 产品, 多通道 TIA 支持 250um/500um/750um 多种不同的通道间距。芯片具有高带宽、低功耗的特点, driver 芯片输出幅度大, 兼容数字和模拟两种控制方式; TIA 芯片输入噪声低, BER floor 低, 输出幅度可调。

苏州鼎芯光电科技有限公司

展位号: 11E55

所属展区: 信息通信展



公司简介:

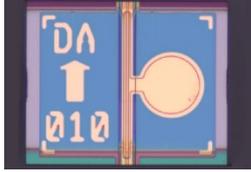
苏州鼎芯光电科技有限公司是永鼎集团控股子公司, 从事高端半导体光芯片的设计研发和制造。公司拥有超过 4000 平方米千级以上的半导体芯片专业洁净车间, 覆盖外延、刻蚀、光刻、镀膜、磨抛、封装、测试芯片的全链条工艺能力。公司主营业务为通信半导体 VCSEL 芯片、DFB 激光器芯片、EML 激光器芯片, 被广泛运用在 5G 通信传输、数据中心和云计算、AI 和数据科学、消费电子等领域。



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

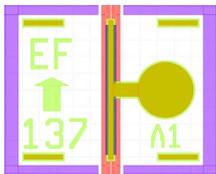
DML 10G 1271nm CWDM/MWDM Chip



产品介绍:

此款产品采用了含 Al 材料作为多量子阱有源层结构，并采用双沟脊波导结构，实现了宽的温度范围内 (0°C-85°C) 波特率均能达到 10.5Gb/sec，同时由于工艺及设计的先进性，此款产品拥有低阈值，高出光效率，高边模抑制比以及高良率低成本的优势。为保证实际网络传输中信号的可靠度，此款芯片产品通过 Telcordia GR-468 标准的检验，并在所有芯片出货前均经历严格的 Certification 流程。波长覆盖 1270nm XGS-PON ONU 应用，以及 CWDM4 4 波长和 MWDM 12 波。

DML 25G CWDM4 Chip



产品介绍:

此款产品采用了含 Al 材料作为多量子阱有源层结构，并采用双沟脊波导结构，实现了工业温度范围 (-40C~85C) 范围内都能实现 25Gbps 的波特率。由于工艺及设计的先进性，此款产品拥有低阈值，高出光效率，高边模抑制比以及高良率低成本的优势。为保证实际网络传输中信号的可靠度，此款芯片产品通过全套 Telcordia GR-468 标准的检验，并在所有芯片出货前均经历严格的 Certification 流程，以确保产品的高可靠性。波长覆盖 CWDM4 4 波长 (1271nm,1291nm,1311nm,1331) 。

EML 10G 1577nm/DWDM chip



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



产品介绍:

此款产品采用多量子阱有源层,并单片集成 EA 调制器及 DFB 激光器。工作温度为 45C~55C,主要用于 XGSPON OLT; EML 10G TDM/DWDM Chip。此款产品采用掩埋异质结结构,兼顾高可靠性和高性能的需求,同时拥有低阈值,高出光效率,高边模抑制比以及高良率低成本的优势。为保证实际网络传输中信号的可靠度,此款芯片产品通过全套 Telcordia GR-468 标准的检验,并在所有芯片出货前均经历严格的 Certification 流程,以确保产品的高可靠性。

厦门市三安集成电路有限公司

展位号: 12B61

所属展区: 信息通信展

VCSEL



产品介绍:

VCSEL(Vertical Cavity Surface Emitting Laser), 即垂直腔面发射激光器,具有阈值电流小,发光效率高、波长可选择、耦合效率高、尺寸小等优点。目前,三安集成已实现 10G VCSEL 量产, 25G VCSEL 已经在客户端验证通过,消费端 VCSEL 产品目前在开发过程中。

度亘核芯光电技术(苏州)有限公司

展位号: 12C25

所属展区: 信息通信展



扫码参观登记

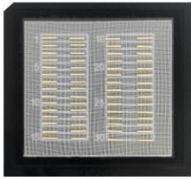
2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

DoGain

公司简介:

度亘核芯光电技术(苏州)有限公司成立于2017年5月,注册资本2.3亿元,公司以高端激光芯片的设计与制造为核心竞争力,聚焦光电产业链上游,拥有覆盖化合物半导体激光器芯片设计、外延生长、器件工艺、芯片封装、测试表征、可靠性验证以及功能模块等全套工程技术能力和量产制造能力,专注于高性能、高功率、高可靠性光电芯片及器件的设计、研发和制造。目前,公司已形成由高功率芯片、980nm单模泵浦模块、阵列激光器、VCSEL、光纤耦合模块构成的五大类、多系列产品矩阵,产品广泛应用于工业加工、智能感知、3D传感、光通讯、医疗美容和科学研究领域,致力打造具有国际行业地位的产品研发中心和生产制造商。

高功率多模单管/巴条芯片



产品介绍:

高功率单管芯片 波长范围: 700nm~1100nm 功率范围: 5W~45W 发光宽度: 100 μ m~320 μ m 腔长范围: 1mm~5.5mm 偏振: TE 95%~97% 产品特点: 高偏振度, 小发散角, 高电光效率, 高波长一致性 高功率巴条芯片 波长范围: 700nm~1100nm 功率范围: CW:50W~200W QCW:100W~700W 填充因子: 20%~80% 腔长范围: 1mm~4 mm 偏振: TE 产品具有高电光效率, 高腔面损伤阈值 (COMD), 高波长一致性

上海新微半导体有限公司

展位号: 12C61

所属展区: 信息通信展





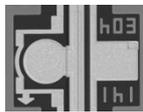
扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

公司简介：

上海新微半导体有限公司（简称“新微半导体”），成立于2020年初，位于上海市临港新片区，一期洁净室面积8300平方米。新微半导体拥有一流的工艺制程和特色的解决方案，专注于为射频、光电和功率三大应用领域提供化合物半导体芯片制造服务，可以满足客户多元化需求。产品广泛应用于通讯、新能源、消费电子、汽车、工业和生物医药等众多终端应用领域。同时，新微半导体亦提供设计支持与晶圆/芯片测试等增值服务，以缩短客制产品进入市场的时间，为客户创造更高的商业价值。

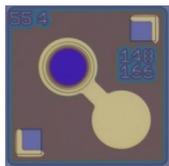
10G DFB Laser Chip



产品介绍：

基于磷化铟材料的10G DFB Laser光发射芯片具有低阈值、高功率，工业级温度和高可靠性特性，产品可用于光纤通信、数据中心和接入网等领域。芯片结构为含Al量子阱、脊波导结构；运用MOCVD设备生长外延片、光栅层二次外延；主要晶圆制造工艺包括Stepper曝光、EBL光栅曝光、ICP刻蚀光栅、E-Gun/sputter金属、自动腐蚀/清洗、减薄和划裂等。

APD 芯片



产品介绍：

新微半导体已完成基于平面结雪崩光电探测器的全工艺开发，运用MOCVD设备生长外延片和Zn扩散，晶圆制造工艺包括Stepper曝光、E-Gun/sputter金属工艺、自动腐蚀/清洗、BCB、ICP干法/湿法刻蚀、减薄、划裂等工艺技术，产品可应用于光纤通信、近红外成像、激光雷达等市场。

PD 芯片



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

**产品介绍:**

新微半导体已完成基于平面结与台面结的 3/4 吋光电探测器的全工艺开发, 运用 MOCVD 设备生长外延片和 Zn 扩散, 晶圆制造工艺包括 Stepper 曝光、E-Gun/sputter 金属工艺、自动腐蚀/清洗、BCB、ICP 干法/湿法刻蚀、减薄、划裂等工艺技术, 产品可应用于光纤通信、近红外成像、激光雷达等市场。

鹏瞰科技(上海)有限公司

展位号: 11E53

所属展区: 信息通信展

**公司简介:**

鹏瞰科技致力于光纤网络的前沿技术开发, 提供超低时延、高安全、高可靠、低功耗及可扩展的端到端工业连接芯片及全栈式解决方案, 满足 AI 处理器和高级传感器的无尽需求, 面向机器人、工业 4.0、F5G 和智能汽车等多领域应用, 实现真正的高效互联互通。公司于 2019 年 6 月由国内外知名的半导体高管和技术专家在上海创立, 目前在中国及全球设有多个研发中心。首款 TS-PON SoC 芯片已经成功流片, 升级迭代的同时支持 XGS/XG/GPON 标准的 SoC 芯片也已成功流片并将在 2023 年 8 月量产。当前已与多家头部企业达成深度合作, 通过全新网络传输及控制架构, 打破制约边缘计算大规模发展的瓶颈。

VN1802 GPON OLT 芯片**产品介绍:**

VN1802 是一款高度集成的单芯片、高性能 PON OLT SoC, 支持 GPON, 为 FTTR 应用提供功能丰富且经济高效的解决方案。VN1802 集成了标准 PON MAC、网络交换引擎 (NSE)、



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

SoC 子系统和 NNI 以太网端口，支持 HSGMII (2.5G) 和 10Gbps XFI、KR 和 USXGMII 接口，以及许多其他常见的外围接口。VN1802 是业界第一款可用于 FTTR 应用的 ASIC 方案，相比 FPGA 方案其低功耗、低成本、高性能、高可靠等特性使得 FTTR 真正迈入可商用和可大规模推广

武汉光安伦光电技术有限公司

展位号： 11C26

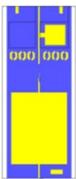
所属展区： 信息通信展



公司简介：

公司于 2015 年成立，总投资额达 3 亿余元。现有员工 200 余人，技术人员比例近 50%。公司厂房面积 6000 余平方米，其中无尘净化车间面积 4000 余平方米，是国内领先的从外延生长、芯片设计、芯片制造、工艺开发以及芯片封测全流程光芯片厂家，产能 800 万/月，产品主要应用于光纤通讯、传感等领域，致力于创立国际一流的光电子芯片品牌，提供有竞争力的光电子芯片产品。 公司长期与国内外大学和科研院所等机构展开技术合作，立足于 25G 及以下速率的 DFB、APD、EML、PIN 等光收发芯片的稳定供应，同时跟踪高速芯片的技术前沿，目前在高速光芯片领域拥有多项发明专利，如 50G/100G EML/SOA 集成芯片等。

光通信芯片及材料



产品介绍：

10G 1577/1550nm EML

厦门优迅高速芯片有限公司

展位号： 11C33



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

所属展区： 信息通信展

**公司简介：**

厦门优迅高速芯片有限公司成立于 2003 年 2 月,是国家规划布局内重点集成电路设计企业、国家级专精特新小巨人企业,是国内光通信行业领军企业。公司拥有一支“高精尖”的本土化技术团队,研发能力达到国际先进、国内领先水平,产品涵盖 155Mbps~400Gbps 的光通信前端核心收发电芯片。厦门优迅坚持自主创新、正向设计,已形成自主知识产权百余项,参与制定国家通信行业标准 20 余项,是国家知识产权优势企业,并承担并完成国家级重大研发项目。

XGPON OLT 方案：UX3367S+UX2420S**产品介绍：**

UX3367S 包括带 CDR 的 10Gbps EML 激光驱动器和 2.5Gbps 突发模式限幅放大器,可用于 XGPON OLT 光模块。UX2420S 是用于 XG-PON OLT 接收的高灵敏度突发模式跨阻放大器。UX6001/UX6002 是 32 位光通信用的微控制器,可以与 XGPON OLT 方案搭配使用。

XGSPON OLT 方案：UX3366S+UX2461**产品介绍：**

UX3366S 包括带 CDR 的 10Gbps EML 激光驱动器和突发模式限幅放大器,可用于 XGSPON



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

OLT 光模块。UX2461 是突发模式跨阻放大器，专门设计符合 XGSPON OLT 应用需要的灵敏度和相应时间。UX6001/UX6002 是 32 位光通信用的微控制器，可以与 XGSPON OLT 方案搭配使用。

福建中科光芯光电科技有限公司

展位号： 11C25

所属展区： 信息通信展

Litecore

公司简介：

福建中科光芯光电科技有限公司成立于 2011 年，由苏辉博士创立。是一家拥有自主知识产权，研发生产光芯片、器件和模块的高新技术企业。中科光芯以福州、石狮为研发和生产基地，在武汉和深圳设有研发中心，已累计销售超过 1.5 亿颗光芯片及器件，产品得到了国内主流通讯厂商的认可。同时，中科光芯与特发信息、科大国盾、中兴光电子等企业开展科研合作，涉及硅光、量子通讯等产业重大需求前瞻性项目，与中科院物构所、中科院半导体所、清华大学等科研单位及高校开展产学研合作，承接了众多前沿科研项目，吸引了君联资本、复星投资等机构投资。我们的愿景是成为全球最有影响力的光芯片企业。

2"3"外延片



产品介绍：

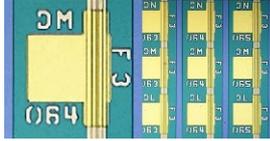
1、通过 MOCVD 在 InP 衬底上生长 InP/InGaAsP 或 InP/InGaAlAs 激光外延结构，提供中心波长从 1250nm 至 1650nm 的各类 FP 及 DFB 激光器外延片；2、特征 中心波长从 1250 至 1650nm 厚度误差控制在 5%以内 掺杂浓度 $1e17$ 至 $1e19$ ，误差控制在 20%以内材料缺陷低 $50cm^{-2}(D>10um)$ 。



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

2.5G/10G/25G 芯片



产品介绍:

1、描述：对外延片进行镀膜、光刻、刻蚀、腐蚀、清洗、以及光栅再生长等工序形成芯片；进行解离、镀膜、测试等形成合格的芯片 2、特征： 响应波长 1250nm~1650nm 直调速率 2.5Gbps/10 Gbps/25Gbps 1310nm DFB LR/25Gbps 1270~1370nm DFB CWDM/1550nm 高功率 DFB 激光器 符合 RoHS

无锡神州高芯科技有限公司

展位号： 11C75

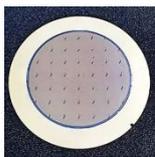
所属展区： 信息通信展



公司简介:

无锡神州高芯科技有限公司是一家专注于高端光芯片开发设计公司,公司拥有资深的激光芯片设计、工艺、运营管理专家团队,可以配合支持客户在新产品上的芯片开发要求,在无锡与深圳分别成立研发中心,负责配合客户后端的产品测试验证,以保证良好产品售后服务。公司现有 10G/40G、 25G/100G、 50/200G VCSEL, 单波 50G/100G VCSEL, HDMI VCSEL, 10G 灰光, 10G BIDI 工业级、10G CWDM DFB 激光器等产品,已经过主流厂家验证并量产。

芯片



产品介绍:

VCSEL 芯片: 现有 10G/40G, 25G/100G,50/200G PAM4 VCSEL 芯片, 高芯的 VCSEL 在



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

COB&TO 封装形式下,可以满足工业级要求。50G/200G VCSEL 芯片可以支持 DSP 和 CDR 应用。高芯可以提供 VCSEL TO 封装, 1x12 VCSEL 等定制化和服务。DFB 芯片: 高芯提供 10G PON, 10G 灰光, 10G BiDi, 10G CWDM 前 6 波 DFB 芯片。高芯的 DFB 可以满足工业级要求。

苏州领慧立芯科技有限公司

展位号: 12D812

所属展区: 信息通信展



公司简介:

苏州领慧立芯科技有限公司(简称:领慧立芯)专注于高性能模拟及混合信号芯片开发设计。创始团队成员均来自知名芯片设计公司,平均设计开发经验大于十年,熟稔产品定义、设计研发、测试量产、运营销售等各个环节。公司致力于中高端数模混合产品的研发,产品主要涉及高精密信号链和集成信号链 MCU/SOC 两大方向,关键性能指标处于业内领先水平,广泛应用于光通讯设备、工业控制、医疗仪器和汽车电子等领域。公司技术已得到了包括汇川技术、旭创科技、光迅科技和麦格米特等工业客户的认可。公司坚持以人为本,以创新为驱动,以市场为导向,持续不断地推出更有竞争力的产品,志在成为高性能模拟及混合信号芯片领域的领军者。

LH32M3XX



产品介绍:

LH32M3XX 系列 MCU 是完全集成的单封装器件,集成高性能模拟外设和数字外设和 72 MHz ARM Cortex-M3 处理器。LH32M3XX 采用低功耗 ARM Cortex-M3 处理器,32 位 RISC 处理器的峰值性能最高可达 90MIPS。片上 PLL 支持 72MHz 时钟频率。集成 2 个 128 kB Flash 存储器和 1 个 32 kB SRAM,两个 Flash 支持地址交换。集成了多路输入 12bit ADC (外部 16 路,4 路片内),4 路 12bit VDAC,内置温度传感器和 4 路模拟比较器。



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

苏州苏纳光电有限公司

展位号： 11B808

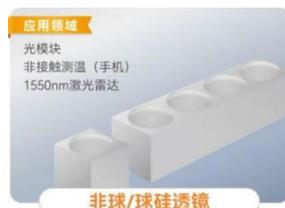
所属展区： 信息通信展



公司简介：

苏州苏纳光电有限公司成立于 2014 年，依托于中国科学院的技术优势，以“光通信、光传感“中国芯””为企业愿景，致力于打造具有自主知识产权和核心竞争力的国产芯片，打破国外垄断，攻克“卡脖子”技术，实现高端芯片的国产化替代。公司产品位于光通信产业链最上游，产品主要包括硅透镜、熔融石英透镜、硅基热沉及微槽、InGaAs 激光器及探测器等，其中晶圆级刻蚀微透镜芯片是公司的核心产品，产品已服务 130 余家的国内外光模块企业。在光通信之外，公司的晶圆级刻蚀微透镜芯片也广泛的应用于激光雷达、非接触测温（消费电子）、汽车微投影（迎宾灯等）、光栅尺等领域，已实现主流厂商的批量出货。

非球/球硅透镜



产品介绍：

硅透镜产品在国内处于领先地位 国内 90%以上光模块企业均是苏纳客户 已实现 2600 万只以上硅透镜芯片的批量出货(其中非球透镜 600 万只) 全球第三家成功推出 400G 模块用球硅透镜阵列/非球硅透镜厂家 现可量产 100 余种硅基球透镜，70 余种硅基非球透镜，为客户提供定制化产品超百款。 产品应用在：光模块、非接触测温（手机）、1550nm 激光雷达等领域

华芯半导体科技有限公司

展位号： 12A23



扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

所属展区：信息通信展



公司简介：

华芯半导体科技有限公司位于泰州市姜堰区现代科技产业园，投资超 5 亿元，占地面积 90 余亩，建筑面积 50000 平米。公司拥有国际先进的外延金属有机物化学气相沉积(MOCVD)设备、芯片工艺设备和封装设备等，主要从事尖端化合物半导体光电子芯片的研究、开发与生产。公司主要产品为垂直腔面发射激光芯片(VCSEL)、蓝绿光半导体激光芯片等。公司产品主要应用于光纤通信、数据中心、云计算、超算、激光雷达，人脸识别、激光显示、激光照明、激光电视等领域。公司愿景与展望：以砷化镓材料体系的 VCSEL 芯片为基础，打造一个国际领先的化合物半导体芯片工艺平台。在该平台上，可以一站式生产各种材料体系的化合物。

850nm 56G 系列 VCSEL 芯片



产品介绍：

产品特征：850nm 多模激光输出；低阈值电流和低工作电流；高可靠性，低功耗；低寄生电容；高低温稳定性；高波长稳定性；56Gpbs 调制速率。 应用领域：高速光通信；大数据中心；芯片互联

日照市艾锐光电科技有限公司

展位号： 12C21

所属展区： 信息通信展



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

AZURi Optics

公司简介:

艾锐光电 (Azuri Optics Technologies) 科技有限公司于 2016 年底成立, 致力于通信产业高速光芯片技术领域。以国际领先的啁啾控制技术为切入点, 集中在 10G DML、25G DFB/FP 等高端激光器芯片的设计研发, 同时提供相关的光组件、光模块等产品及方案, 面向 10G-PON、5G 无线前传、及 POL 工业互联网, 数据中心等市场应用, 相关产品已经通过国际知名大公司的测试及验证。艾锐光电初创团队核心人员来自中美国际知名公司及机构, 具有近 20 年的研发、管理和销售经验, 并在核心光芯片领域具备深厚技术积累。

10G 1270nm DML 激光器芯片



产品介绍:

AZURi 10G 1270nm DML 激光器是一种基于脊波导结构的分布反馈(DFB)单纵模边发射半导体激光器, 其有源区采用 AlGaInAs 材料的应变多量子阱结构。芯片的前、后出光面分别镀有高反膜和增透膜。其具有低阈值电流、大输出功率、小发散角以及低功耗的特点, 满足 25 °C ~ 85°C 环境下的非制冷应用需求。

宁波元芯光电子科技有限公司

展位号: 11A25

所属展区: 信息通信展



ORI CHIP

公司简介:

宁波元芯光电子科技有限公司是一家以 IDM 模式自主研发、生产、测试、销售半导体激光

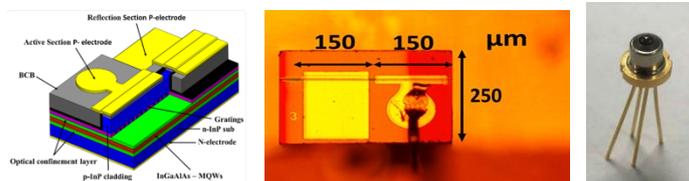


扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

器芯片的高科技企业。公司研发实力雄厚，凝聚了众多半导体激光器领域的优秀人才，建成了完整的高精度化合物半导体生产线，始终致力于向国内外光器件和光模块用户提供高性价比、高可靠性的半导体激光器芯片和高品质的技术服务。公司的产品在性能上具备国内领先、世界一流的水平，完全拥有自主知识产权及多项核心专利，并获取多项行业荣誉称号，在推动行业不断进步的同时，更以中国光通信芯片解决方案引领者的姿态迈向世界。

25G 高速直调分布式反馈激光器芯片



产品介绍：

基于我们独创的设计，我们的DFB激光器具有55dB的边模抑制比，且在-40°C到85°C不跳模。波长准确度做到 ± 1 纳米在常温和85°C下，该DFB激光器在60mA注入电流情况下分别实现了大约23GHz和18GHz的3-dB调制带宽。

中电科芯片技术（集团）有限公司

展位号：12D31-2

所属展区：信息通信展

光通信用探测器芯片、激光器芯片及器件模组等



产品介绍：

拥有完整的半导体光电探测器/激光器芯片生产线，产品包含2.5G/10G DFB、2.5G/10G/25G APD、25G/4*25G PD等多类光收发芯片，及TO、OSA封装生产线，是国内光通信领域的主流供应商。



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

飞昂创新科技南通有限公司

展位号: 11A63

所属展区: 信息通信展

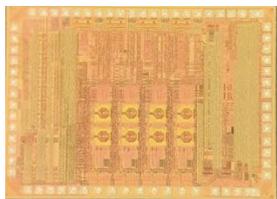


飞昂创新 WINGCOMM

公司简介:

飞昂创新科技南通有限公司核心技术为 25G/100G/400G 高速光电集成电路和集成光路, 自 2014 年以来, 专注于光通讯领域超高速光互连集成电路的产业化, 成功研发并量产了光模块, 有源光纤和光引擎中的电芯片产品。广泛应用于数据中心、无线基站、超级计算机、4K/8K 超清视频等领域。是目前我国首家具备 25G/100G/400G 高速光互连芯片量产能力, 并已实现规模商用的本土企业。打破了国外企业在这一领域的长期垄断, 加速推动了国内 25G/100G/400G 光互连技术的大规模商业应用。

FA6421 / FA6422



产品介绍:

Optoelectronic Transceiver Chipset with 4x Vcsel Driver and PIN TIA Target application:
All fiber or Hybrid AOC for HDMI 2.1 + DisplayPort 1.4

苏州长瑞光电有限公司

展位号: 12C75

所属展区: 信息通信展



公司简介:



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

苏州长瑞光电有限公司主要从事 III-V 族半导体激光器芯片的研发、设计、晶圆制造和封装测试，产品主要应用于高速光通信与消费类电子产品。公司致力于开发低功耗、低成本、高性能、长寿命的半导体激光器芯片，并成为具有量产能力的国产光芯片供应商。

垂直腔面发射激光器



产品介绍:

型号描述: HC-YR4085 功能特性: Wavelength: 850nm Bandwidth: 19 GHz Application: 200G SR4/400G SR8、200G/400G AOC Status: Mass production 应用: 200G SR4; 400G SR8; 200G/400G AOC

微龛（广州）半导体有限公司

展位号: 11D62

所属展区: 信息通信展



公司简介:

微龛（广州）半导体有限公司创建于 2016 年，是一家高性能模拟信号链集成电路方案供应商，国家高新技术企业。微龛半导体针对 5G 基站、数据中心、光纤接入等场景的多样需求，积极为通讯模组与设备厂商提供自主可控、高性价比的光通信、模拟/数模混合系列化芯片产品及系统解决方案。

四通道 25Gbps 时钟数据恢复及跨阻放大器集成模块



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



产品介绍:

支持速率: 25.2~28.1Gbps -12dBm 典型灵敏度: BER 1E-12, 25.78Gbps, ER=4dB 高灵敏度限幅放大器及 LOS 判断 单通道典型功耗 223mW 无参考时钟以及带宽可调 CDR, 并支持 bypass 模式 输出支持预加重以及编程处理 支持时钟监控, 输出 8/16 分频时钟 数字诊断监控 RSSI 电流 支持-40°C至 95°C芯片工作温度。

杭州芯耘光电科技有限公司

展位号: 11B21

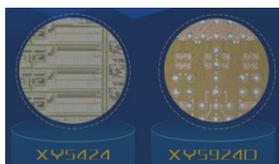
所属展区: 信息通信展



公司简介:

杭州芯耘光电科技有限公司于 2017 年 4 月正式开始运营, 公司坐落于浙江省杭州市临平区余杭经济技术开发区东湖街道兴中路 282 号; 致力于新一代硅光子技术、超高速模拟信号链集成电路产品的开发, 目前主要从事 100G+芯片, 光电器件、光电传感器产品的开发、生产、销售; 面向数据感知、云计算、数据高速链接和 5G 网络建设等领域提供整套解决方案。

100G LR4/CWDM4/PSM4 CDR 集成套片



产品介绍:

XY5924D+XY5424 是带 DML 驱动器和 TIA 的高性能 4*28G CDR 集成套片。XY5924D 是 CDR+DML driver, 具有高输入抖动容限、低输出抖动和可调 DFB 激光器偏置和调制电流, 支持输入端 50Ω终端的差分 AC 耦合信号, 具有 25Ω终端和用于激光阳极 (TOUTAx) 和激



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

光阴极 (TOUTCx) 的专用引脚。芯片以 eWLB 封装形式提供。XY5424 是 CDR+TIA 集成芯片, XY5424_BT2 为 250um 版本, XY5424_BT7 为 750um 版本。该芯片以裸片形式提供。

山西国惠光电科技有限公司

展位号: 12E633

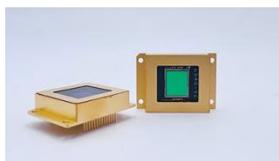
所属展区: 信息通信展



公司简介:

山西国惠光电科技有限公司成立于 2011 年, 位于太原高新区, 始终致力于光电行业前沿技术的研发和产业化, 拥有国际水准的 4 英寸 III-V 族半导体化合物芯片生产线, 自主研发并实现工程化生产的红外焦平面探测器芯片及其成像系统, 其指标已达到国际先进水平。 公司具有微纳米半导体光电器件设计、制造、测试、封装等专业生产设备及其工艺实现条件, 以及整机装配、环境试验、系统测试等全过程的检测与生产能力。

InGaAs 短波红外双波段焦平面探测器



产品介绍:

国惠光电自主研发生产的可见光-短波红外焦平面阵列探测器, 将传统的碲镓砷探测器的光谱响应范围从 900-1700nm 延展到 400-1700nm。 可同时实现对可见光, 近红外和短波红外的探测和成像。 有效地结合了不同波段在其成像及光谱分析方面的优势, 在多光谱和高光谱成像等方面都有十分广泛的应用

深圳博升光电科技有限公司

展位号: 12D71



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

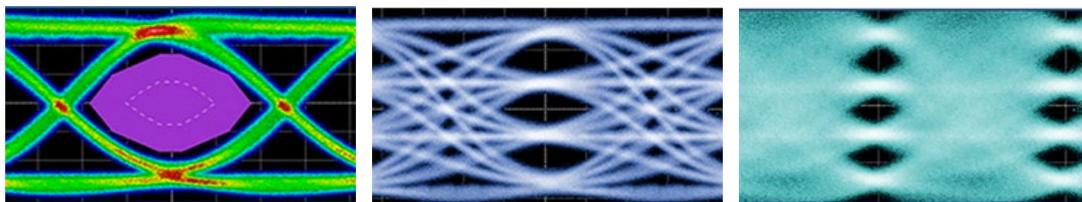
所属展区： 信息通信展



公司简介：

博升光电是技术领先的光电半导体科技企业，是技术领先的光电半导体科技企业，致力于为 AI 计算、云数据中心、智能制造以及智能汽车等行业，提供领先的高速率 VCSELs 及高性能 3D 视觉解决方案。博升光电芯片设计及研发人员均具有博士后、博士、硕士学历，核心团队在芯片材料、外延生长、芯片工艺、芯片测试，以及 3D 光学系统等核心领域拥有超过 20 年以上的工作经验。博升光电组建了“深圳市超结构光子芯片重点实验室”，该实验室具备目前世界上最先进的光电芯片研发和测试能力。公司半导体集成芯片创新平台，具备目前世界上最先进的光电芯片工艺设备和工艺能力，并提供产品快速定制、以及代工服务。

高速光通信 VCSEL 光芯片



产品介绍：

高速光通信 VCSEL 光芯片，25G NRZ、50G PAM4、100G PAM4

桂林光隆科技股份有限公司

展位号： 11A15

所属展区： 信息通信展



公司简介：

光隆科技是一家以光芯片为基础的多领域应用提供商。提供通信与非通信类光芯片（晶圆 / bar 条 / 芯片），半导体制程服务（外延 / 封测），及光隔离器、MEMS、5G 前传半有源

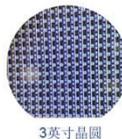


扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

模块等产品。通过子公司产品及市场关联协同延伸产业链布局。

半导体激光器芯片



3英寸晶圆



DFB LD



HP LD

产品介绍：

雷光科技专注于制造高端半导体激光芯片，产品主要用于数据通信和电信市场。3英寸晶圆：3英寸晶圆上每颗芯片都有唯一的代号，测试后能做局部分析 mapping。DFB 激光器芯片：DFB 激光器，即分布式反馈激光器，内置布拉格光栅，属于边发射的半导体激光器。在光通信领域中主要以磷化铟(InP)半导体材料为介质。产品特性：窄线宽、宽温域、波长稳、高速率。产品应用：5G 通信、激光传感、光纤到户、数据中心。

深圳逍遥科技有限公司

展位号： 12D62

所属展区： 信息通信展



公司简介：

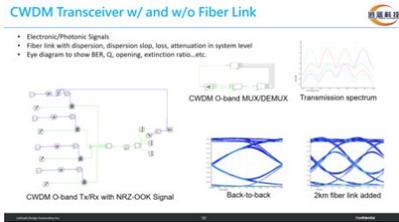
深圳逍遥科技有限公司是 2021 年初成立的高科技软件企业。总部位于深圳，在成都、无锡、台湾新竹设有研发和晶圆代工厂工艺设计套件（PDK）服务中心。逍遥科技致力于为“特色工艺”半导体芯片设计提供自动化解决方案。特色工艺半导体芯片应用领域广泛，包括光电子、功率器件、MEMS/智能传感、模拟/射频芯片等。由于芯片版图布线方式、标准参数化单元（PCell）、特征尺寸、材料对信号传输的影响等方面，与数字电路芯片存在较大差异，传统 EDA 工具难以满足特色工艺芯片的设计需求。逍遥科技将与广大业界同行一起努力，加速实现 EDA 软件的国产化进程。为中国半导体产业的发展贡献力量，为广大客户创造价值！

pSim 硅光芯片链路仿真器



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



产品介绍:

pSim 是硅光芯片链路仿真工具,可验证多模、双向和多通道光电链路,在时域或频域进行分析。其提供类似于传统 EDA 电子电路工具基于电路图的设计环境,方便设计由众多组件所组成的光电链路。分层设计环境及可视化直观操作接口使得设计者能轻松通过将各个组件相互连接并仿真分析整体系统,验证系统在时域及频域上的响应。内建链路范例包含解多工链路、光探测器的敏感度和线性度分析、调制器分析、行波调制器分析、CWDM 以及相干光收发器包含光纤的信号传输质量分析。

宏芯科技(泉州)有限公司

展位号: 12C73

所属展区: 信息通信展



公司简介:

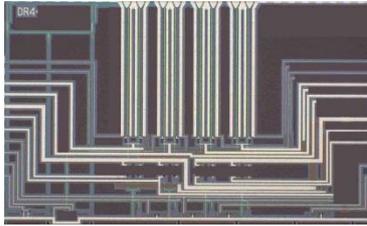
宏芯科技(泉州)有限公司是一家专注于数据中心和 5G 承载网用硅光芯片与模块的研发与生产的高新技术企业,总部位于福建省泉州市,并在北京市中关村和武汉市光谷设立研发中心。宏芯科技拥有国际一流的硅光芯片与模块技术,研发和生产的 100/200/400/800G 硅光芯片与模块,可以满足光模块制造商、光通信设备商、云服务商、电信运营商等的海量需求。宏芯科技基于独创的高速率电光调制和高效率光耦合技术,开发出具有完全自主知识产权的系列硅光芯片,并基于上述芯片开发了硅光模块系列产品,具有封装简洁、成本低、功耗低、消光比高的特点,覆盖了数通和电信等大部分领域的需求。

400G 硅光 DR4 发射芯片



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



产品介绍:

- 速率: 4×100 Gbps PAM4
- 工作波长: 1310 nm
- 单通道插损: <4.5 dB
- 电光带宽: >38 GHz
- 差分阻抗: 60 ohms
- 差分驱动电压: 3.5 Vppd
- 消光比: >4.5 dB
- 工作温度: 0~70 °C

中科微光子科技（成都）有限公司

展位号: 11A65-3

所属展区: 信息通信展



公司简介:

中科微光子科技（成都）有限公司成立于 2019 年，基于中科院微电子所 8 英寸 CMOS 工艺线开发并提供硅光工艺技术服务，主要从事硅基光电子器件及集成芯片的制备和测试等技术服务，致力于成为行业领先的硅光芯片制造及 IP 等硅光一站式服务提供商。公司产品及服务广泛面向光通信、数据中心、光量子计算、激光雷达、微波光子、生物传感等应用领域，目前已与清华、北大等高校科研机构及硅光各应用领域龙头企业建立良好深度合作，累积服务客户 200+家。

硅光晶圆制造流片服务



产品介绍:

中科院微电子所硅光平台对外提供基于 8 英寸 SOI 的光子集成流片服务以及 8 英寸硅基 SiN



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

光子集成流片服务。基于 SOI 的工艺模块包括 220 nm/150 nm/70 nm 无源器件刻蚀工艺、高速调制器掺杂工艺、TiN 加热电极工艺、锗材料外延工艺、硅和锗的欧姆接触及金属层工艺等。平台每年可对外提供 6-8 次 MPW 流片服务。同时为了满足客户的特殊工艺要求，可提供工艺定制服务。基于硅基 SiN 的光子集成流片服务以定制化为主，平台已实现 SiN 器件库。

上海米硅科技有限公司

展位号： 12D33

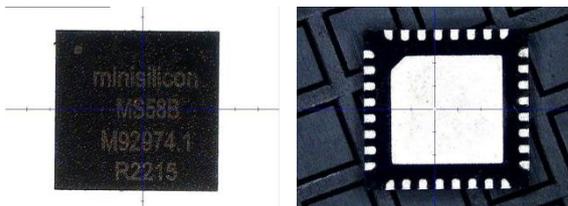
所属展区： 信息通信展



公司简介：

米硅是一家行业领先并致力于混合信号和时序芯片研发、销售一体的公司。公司为客户提供用于光通信的多种电子芯片产品组合，包括云服务、数据中心网络、5G 网络以及 FTTx-固网接入网络，能有效解决光电转换之间的高性能模拟接口问题，并提供多元化解方案以满足当今高速网络对尺寸、功耗和信号完整性的苛刻要求。产品包括了高性能激光二极管驱动器、跨阻放大器、时钟数据恢复和限幅放大器，分别适用于运行高达 400 Gbps 及以上的数据中心、企业和电信光网通讯系统；适用于 10G EPON、XGPON 和 XGSPON 系统的最广泛的光放大器和 TIA 产品组合；高性能 5G 收发器、简单的扇出缓冲器以及专为光模块设计的 MCU。

ms58000 -XGS PON OLT 收发芯片



产品介绍：

ms58000 是具有高集成度的收发芯片，满足 XGS PON 应用需求。发射端带有均衡及预加重功能，集成 APC 自动功率控制及多项眼图调整功能，可采集数字诊断 DDM 所需温度，电压和电流等信息。高灵敏度限幅放大器，集成 AC 耦合电容以及放电开关，实现快速突发模式



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)

信号检测，输出幅度可调，支持灵活的脉冲展宽时间设置。

湖北赛格瑞新能源科技有限公司

展位号： 11C815-1

所属展区： 信息通信展



公司简介：

湖北赛格瑞新能源科技有限公司是一家以“专注于半导体热电技术及应用”为战略定位的国家高新技术企业。公司集研发、生产和市场服务于一体，致力于为广大客户提供专业化半导体制冷与温差发电材料、C-TEC 芯片、Micro-TEC 芯片、TEG 芯片、半导体制冷与温差发电系统解决方案。拥有自主研发纳米晶热电材料技术，年产能 50 吨以上；C-TEC 芯片、Micro-TEC 芯片、TEG 芯片生产产能超过 500 万只，产品型号超过 100 余种。实现光模块精准控温关键技术国产化，打破国外技术垄断，解决了国内无法生产小微型器件的瓶颈。

Micro-TEC



产品介绍：

一种微型半导体致冷芯片，可实现主动致冷，具有体积小，响应迅速的优点，主要应用于激光通讯、激光吸收光谱、光谱学等领域，用于实现光芯片的精准控温，控温精度可达 0.01°C。



扫码参观登记

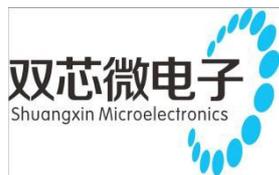
🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

Micro-TEC 自主可控，打破国际垄断完全国产化，不惧国际形势变化，拥有敏锐的市场响应速度，已及稳定的交付周期

浙江双芯电子科技有限公司

展位号： 11C73

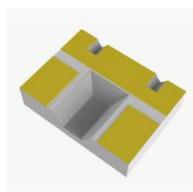
所属展区： 信息通信展



公司简介：

浙江双芯电子科技有限公司成立于 2021 年 10 月，座落于浙江德清经济技术开发区。公司立足半导体集成电路行业，研发和生产各类陶瓷基薄膜电路器件；并涉及微波，毫米波射频组件的研发设计、制造；公司同时具有 TSV、TGV、WLP，SIP 等先进封装产品和微波模块等产品的技术开发能力。公司今后将建设成为国内领先，国际先进的高科技企业，暨成为国产芯片替代进口的新生制造企业。浙江双芯微电子始终关注客户，关爱员工，立足自主技术，竭诚为客户提供最好的服务。

光电薄膜电路



产品介绍：

针对光电应用,我司研发了光电薄膜电路的专用生产工艺及专门定制生产光电产品专用的生产设备,可完成金锡合金预制、侧面金属化,深腔刻蚀以及高精度集成电阻等光电产品。金锡厚度最后可达 10um 以上,电阻精度最高可达±5%以内。

浙江老鹰半导体技术有限公司

展位号： 12A52



扫码参观登记

🕒 2023年9月6-8日 📍 深圳国际会展中心(宝安新馆)

所属展区： 信息通信展

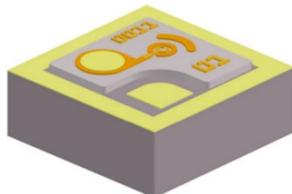


老鹰半导体
ZJEAGLES COMSEMI

公司简介：

老鹰半导体成立于 2018 年 4 月，注册资本 3500 万元，一期投资 5 亿元人民币。公司专注于垂直腔面发射激光器 (VCSEL) 芯片的研发、生产和销售，建有全球领先的仿真设计平台、高级别测量实验室和车规级可靠性试验室。公司目前已形成由高速光通信 VCSEL、高功率密度激光雷达 VCSEL、高效率 3D 感测 VCSEL 以及新型先进封装业务构成的四大产品矩阵，全面赋能数据中心光互联、汽车自动驾驶与智能座舱、消费电子及工业应用的传感与智慧照明等领域，为行业客户提供领先的光解决方案。

50G PAM4 VCSEL 芯片



产品介绍：

850nm 多模垂直腔面发射激光，拥有高可靠性、高一致性、低噪音、低阈值和工作电流等特点。该款产品主要应用到数据中心领域 50G\100G\200G 光模块，支持以太网与云存储数据交换。

苏州易缆微半导体技术有限公司

展位号： 11E11

所属展区： 信息通信展



扫码参观登记

2023年9月6-8日 深圳国际会展中心(宝安新馆)



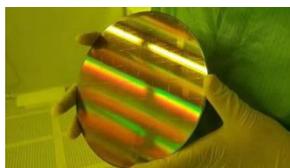
苏州易缆微半导体技术有限公司

Suzhou InnovSemi Co., Ltd.

公司简介:

苏州易缆微半导体技术有限公司成立于 2021 年，注册资本 515 万元，是一家由旅欧归国博士团队创建的中外合资科技型创业公司。公司致力于高密度光纤通信产品（无源和有源）的研发和生产，主打产品包括 100G/400G/800G 硅光子芯片、光学引擎、高端光模块，特种高密度无源产品等。易缆微半导体独创的硅基集成光电子产品开发平台具有平滑演进的技术优势，可以实现低成本、高性能和高密度的光通信和数据中心产品从 40G，100G 向 400G 的快速升级。2021 年 4 月，苏州易缆微半导体的全资子公司苏州易缆微光电完成 Pre-A 轮 1000 万融资。2022 年 9 月，苏州易缆微半导体完成 A 轮 6000 万融资，投后估值 3.5 亿

数据中心 400G 硅光集成芯片



产品介绍:

数据中心 400G 硅光集成芯片： 1、4 通道 4*100Gbps Mach-Zehnder 硅基混合集成调制器
2、工作波段 1290nm-1330nm 3、高带宽响应 4、低半波电压 5、低调制啁啾 6、小尺寸